

第28回エレクトロニクス実装学会春季講演大会プログラム

会期：平成26年3月5日(水)～7日(金) 会場：拓殖大学 文京キャンパス

講演セッション 第1日目 (3月5日) (1/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】
9:30		9:30	「配線板とその製造技術」 座長：和嶋元世 (c-net) 5B-01 低インピーダンスを実現するパッケージ基板のビアスタック構造 赤星知幸 (株式会社富士通研究所)	9:30		9:30	
9:45	「回路・実装設計技術」 座長：豊田啓孝 (岡山大学) 5A-01 無線電力伝送を中継するコイルとケーブルの解析 菊地秀雄 (ST-Lab)	9:45	5B-02 ダイレクトレーザービア工程において発生する銅オーバーハングの磁気研磨法による新規除去技術の検討 (第2報) 片山正彦 (宇都宮大学大学院学際先端システム学専攻)	9:45	「光回路実装技術」 座長：石樽崇明 (慶應大学) 5C-01 依頼講演 JIEP光インターコネクションロードマップWG報告 那須秀行 (古河電気工業株式会社)	9:45	
10:00	5A-02 積層セラミック技術を用いたワイヤレス電力伝送装置の開発 谷田純一 (日本大学理工学部)	10:00	5B-03 ポリイミドマイクロストリップラインの高周波伝送損失と金属層の影響 横沢伊裕 (宇部興産株式会社有機機能材料研究所)			10:00	
10:15	5A-03 励振コイルとして楕円形コイルと円形コイルアレーを用いたワイヤレス電力伝送における磁界分布の比較 堀米滉平 (国土館大学大学院)	10:15	5B-04 分子接合技術に応用した超極薄4層フレキシブルプリント配線板 鈴木大悟 (株式会社東芝)	10:15	5C-02 フォトマスク転写法を用いたインターコネクト向けポリマーV溝基板の作製 榎本忠幸 (東海大学工学部)	10:15	
10:30	休憩	10:30	5B-05 置換反応による直接銅めっき方法を用いた金属化ポリイミドフィルムの作製 金 徳實 (サイチ工業株式会社)	10:30	5C-03 光硬化樹脂を用いた90度光路変換素子の作製 添田幸伸 (東海大学工学部三上研究室)	10:30	
10:45	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：王 建青 (名古屋工業大学) 5A-04 UWB用フレキシブル扇形台形不平衡アンテナの折り曲げに対する特性検討 平栗一也 (国土館大学)	10:45	休憩	10:45	休憩	10:45	
11:00	5A-05 半円台形不平衡ダイポールアンテナの放射パターン改善 櫻井愛里 (国土館大学)	11:00	座長：吉原佐知雄 (宇都宮大学) 5B-06 めっき膜の昇温脱離分析装置 (TDS) による分析—特に、シアンを含まない浴からのめっき膜中のシアンについて— 小岩一郎 (関東学院大学)	11:00	座長：杉原興浩 (東北大学) 5C-04 Mosquito法によるシングルモードポリマー光導波路の作製と低損失化 吉田 翔 (慶應義塾大学理工学部)	11:00	
11:15	5A-06 実装回路搭載アンテナに関する検討 田中幸治 (拓殖大学大学院工学研究科)	11:15	5B-07 微小凹凸面における銅添加剤の吸着機構 高橋夏樹 (関東学院大学大学院工学研究科)	11:15	5C-05 共振器集積導波モード共鳴フィルタの最適共振器長 井上純一 (京都工芸繊維大学)	11:15	
11:30	5A-07 プリント配線板上に形成した薄型UWBアンテナの検討 百瀬大祐 (東京理科大学理工学研究科電気工学専攻)	11:30	5B-08 真空紫外線を利用したフォトデスマイアプロセス 堀部大輝 (ウシオ電機株式会社)	11:30	5C-06 高出力半導体レーザーの高放熱化のための金薄膜を介したGaAs/SiCウェハの低温接合 奥村 拳 (東京大学工学部精密工学科)	11:30	

講演セッション 第1日目 (3月5日) (2/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】
11:45	5A-08 第4世代移動通信用800 MHz・2.0 GHz・UWB帯3周波数帯対応マルチバンドアンテナ 秋山侑祐 (国士舘大学大学院)	11:45	5B-09 狭ピッチ対応極薄無電解Ni/Pd/Auプロセスの開発 大矢怜史 (株式会社クオルテック)	11:45	休憩	11:45	
12:00	5A-09 左手系導波管を用いたミリ波帯スロットアレーアンテナ—インダクタ装荷による放射指向性制御の検討— 小松真奈 (東京理科大学大学院)	12:00	5B-10 塩化銅エッチング廃液からの酸化銅回収と工場内における再利用 小林琢也 (水ing株式会社)	12:00		12:00	
12:15	休憩	12:15	休憩				
13:00	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：井関裕二 (東芝) 5A-10 依頼講演 パワーエレクトロニクス製品のEMI対応フロントローディング設計 玉手道雄 (富士電機株式会社)	13:00	「部品内蔵基板技術」 座長：見山克己 (北海道工業大学) 5B-11 依頼講演 部品内蔵基板の国際標準化動向 友景 肇 (福岡大学)	13:00	「プリンタブルデバイス実装」 座長：井上俊明 (フジクラ) 5C-07 依頼講演 低温焼成銀ナノ微粒子の最新製造技術 栗原正人 (山形大学)	13:00	「材料技術」 座長：高橋昭雄 (横浜国立大学) 5E-01 依頼講演 酸化銀粒子を用いた高耐熱接合技術の開発 保田雄亮 (株式会社日立製作所 日立研究所)
13:30	5A-11 3端子コンデンサを用いたインピーダンス反共振抑制と輻射ノイズ抑制技術の研究 村上嘉英 (株式会社村田製作所)	13:30	5B-12 部品内蔵基板設計対応CAD技術 松澤浩彦 (株式会社 図研)	13:30	5C-08 Cu-Agインクによる金属イオンマイグレーションの抑制 若林正一郎 (昭和電工株式会社)	13:30	5E-02 パワーデバイス用高温はんだの接合技術課題 未次憲一郎 (広島大学産学・地域連携センター)
13:45	5A-12 フェライト膜付プレーナEBG構造の実用化のための検討 豊田啓孝 (岡山大学)	13:45	5B-13 落下試験時の基板内蔵抵抗過渡変化 池原寛介 (福岡大学工学部電子情報工学科)	13:45	5C-09 銀ナノ粒子焼結体への電解銅めっきにおける銀-銅間の密着機構 富士川 亘 (DIC株式会社)	13:45	5E-03 はんだ接続と樹脂補強を同時に行える次世代ソルダペースト 萩尾浩一 (株式会社ニホンゲンマ)
14:00	5A-13 基板対基板コネクタのグラウンド構造によるケーブル放射ノイズの影響 佐野宏靖 (東京都立産業技術研究センター)	14:00	5B-14 4点曲げ試験法を用いた基板内蔵部品の信頼性評価 宗 真太郎 (福岡大学工学部電子情報工学科)	14:00	5C-10 積層セラミックコイルを用いたMEMSロータリーアクチュエータの作製 高藤美泉 (日本大学)	14:00	5E-04 UV照射がリードフレーム上のAgめっき/Cuの密着性に及ぼす影響 奴留湯誉幸 (中央電子工業株式会社)
14:15	5A-14 電源・グラウンド対向部位の形成によるプリント基板のノイズ対策 田中顕裕 (アイカ工業株式会社)	14:15	休憩	14:15	休憩	14:15	5E-05 コールドスプレー銅皮膜の強度支配因子評価 渡邊雄亮 (東北大学大学院 工学研究科 附属エネルギー安全科学国際研究センター)
14:30	休憩	14:30	座長：加藤義尚 (福岡大学) 5B-15 依頼講演 半導体、モジュールから見た部品内蔵基板への期待と課題 八甫谷明彦 (株式会社東芝)	14:30	5C-11 ペーパーエレクトロニクスに向けたフレキシブル透明導電紙の開発 古賀大尚 (大阪大学産業科学研究所)	14:30	休憩
14:45	座長：斉藤義行 (パナソニック) 5A-15 LSI電源系のコモンモードノイズ低減時における電源・グラウンド電圧の位相に関する検討 松嶋 徹 (京都大学大学院工学研究科)			14:45	5C-12 プラスチック基板への直接製膜によるカーボンナノチューブ透明導電膜の開発 阿澄玲子 (独立行政法人産業技術総合研究所)	14:45	座長：井上雅博 (群馬大学) 5E-06 均一粒径白金粉末の開発 岩城典明 (株式会社ノリタケカンパニーリミテド)

講演セッション 第1日目 (3月5日) (3/3)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】		【E会場】
15:00	5A-16 ビッグテールによる放射ノイズの解析 松浦弘明 (拓殖大学)	15:00	5B-16 一括積層PALAPによる部品内蔵基板 長谷川賢一郎 (株式会社デンソー)	15:00	5C-13 高精度・短タクト全印刷トランジスタ形成に向けた一括焼成技術の開発 日下靖之 (産業技術総合研究所)	15:00	5E-07 電気光学KTN結晶を用いた350kHz波長掃引光源 豊田誠治 (NTTフォトニクス研究所)
15:15	5A-17 STPケーブルの非対称なビッグテール接地の影響評価 渡邊陽介 (三菱電機株式会社)	15:15	5B-17 コンデンサ内蔵基板における並列合成容量の実測とシミュレーションの整合検証 大関政広 (株式会社メイコー)	15:15	5C-14 依頼講演 「光前駆体法」を駆使した塗布型有機薄膜太陽電池の開発—材料設計の考え方と積層型デバイスへの展開— 鈴木充朗 (奈良先端科学技術大学院大学)	15:15	5E-08 シアン酸エステルとベンゾオキサジンをを用いた無溶剤型熱硬化性樹脂の高性能化 和田直大 (横浜国立大学院工学府機能発現工学科)
15:30	5A-18 ビッグテールを持つプリント配線のイミューニティ特性の検討 大塚康平 (拓殖大学)	15:30	5B-18 内蔵受動部品の動向と今後の展望 青木 仁 (KOA株式会社)			15:30	5E-09 多結晶薄膜の結晶粒界品質支配因子の解明 範 伝紅 (東北大学工学研究科)
15:45	5A-19 電源線から侵入した外乱に起因するクロックグリッチによるFPGA誤動作事例 五百旗頭健吾 (岡山大学)	15:45	5B-19 薄膜キャパシタ内蔵インターポータ 服部篤典 (株式会社野田スクリーン)	15:45		15:45	5E-10 Znドーブと貴金属触媒効果による拡散加速を利用したCu/ガラス界面の常温接合 寺岡 暁 (山梨大学大学院医学工学総合教育部)
16:00	5A-20 CAN伝送における電磁放射特性の解析評価と抑圧回路の提案 伊部泰貴 (東京工業大学)	16:00		16:00		16:00	5E-11 高分子材料における生体適合性向上を目的としたドライブプロセスの効果の比較検討 中本菜里 (東京大学大学院工学系研究科)

第1日目【3月5日】ものづくりセッション D会場

	座長：井関裕二（東芝）
10:00	5D-01 3Dプリンタとは？ 造形方式、応用、現状と今後の可能性 小林広美（株式会社スリーディー・システムズ・ジャパン）
10:20	5D-02 実装支援システムPC-MountCAMの紹介 北村淳一（ダイナトロン株式会社）
10:40	休憩
	座長：星 幸紀（大昌電子）
11:00	5D-03 変わりつつある基板設計から製造設計へのデータ流通 上矢健也（株式会社 図研）
11:20	5D-04 プラズマケミカルインジケータ／クリーニング用途での各種適用範囲について 深沢信司（株式会社JCU）
11:40	5D-05 ラインセンサを用いたインライン型3次元X線検査装置の開発 上村亮太（名古屋電機工業株式会社）
12:00	休憩
	座長：高木 清（YJC）
13:00	5D-06 過渡熱測定による放熱構造の可視化分析と応用 周 文俊（メンター・グラフィックス・ジャパン株式会社）
13:20	5D-07 VOC対応コンフォーマルコーティング材料を局所的に薄膜塗布出来る自動塗布バルブ 島田隆治（Shimada Appli 合同会社）
13:40	5D-08 高効率、省スペース化を実現したプリント配線板向けプラズマ枚葉装置 浅野敬祐（株式会社JCU）
14:00	5D-09 次世代プリント配線板に向けたレーザ穴加工技術（3） 久世 修（ビアメカニクス株式会社）
14:20	5D-10 プリント回路基板向け 光学式自動レーザーリワーク装置の紹介 菱川昌樹（日本オルボテック株式会社 PCB事業部）

第1日目【3月5日】ポスターショートプレゼン D会場

	座長：林 秀臣（芝浦工業大学）
15:00	5PD-01 ベルチエ素子を用いた温度差発電 吉川 隆（近畿大学工業高等専門学校）
15:05	5PD-02 無電解めっき膜の密着性向上の検討 太田晃平（関西大学システム理工学部機械工学科応用物理研究室）
15:10	5PD-03 溶融鉛フリーはんだ中での炭素鋼材料の初期腐食挙動 上杉広大（群馬工業高等専門学校）
15:15	5PD-04 電源回路の高速精密シュミレーション技術 安倍幹織（中央大学理工学部電気電子情報通信工学科杉本研究室）
15:20	5PD-05 無線電力伝送システムでの整流回路と負荷インピーダンスの関係 小林雅周（中央大学理工学部電気電子情報通信工学科杉本研究室）
15:25	5PD-06 線形性を改善した低電圧信号入力回路に関する検討 彦坂慎吾（中央大学理工学部電気電子情報通信工学科杉本研究室）
15:30	5PD-07 EFT/B試験における不確かさの研究 梁原可恋（拓殖大学）
15:35	5PD-08 マイクロ波送電用マイクロストリップアンテナの高性能化の検討 村上侑樹（東京理科大学）
15:40	5PD-09 硫酸／過酸化水素水溶液による銅のエッチングに対するアルコール添加の効果 関下明日香（八戸工業高等専門学校）
15:45	5PD-10 硫酸銅めっきに対する添加剤効果の速度論的考察 山本祐也（八戸工業高等専門学校）
15:50	5PD-11 半導体パッケージ用ソルダーレジストの信頼性におよぼす物性の影響 椎名桃子（太陽インキ製造株式会社）
15:55	5PD-12 スルーホールビア用銅めっき薄膜の低サイクル疲労寿命評価 矢島直幸（芝浦工業大学大学院）
16:00	5PD-13 アンダーフィル材料の時間依存ポアソン比の測定 島田宏地（芝浦工業大学大学院）
16:05	5PD-14 予防安全システム用高精度ヨーレートセンサ 河口昌源（(株)デンソー）
16:10	5PD-15 端面発光デバイスのフリップチップ実装における高さ制御の試み 青柳昌宏（独立行政法人産業技術総合研究所）

16:30～17:30 ポスタ展示会場

ポスタ前説明質疑応答（ポスタセッションコアタイム）

講演セッション 第2日目 (3月6日) (1/1)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
9:45	「高速高周波・電磁特性技術」 座長：岡 尚人 (三菱電機) 6A-01 人体通信による心電情報のリアルタイム伝送 加藤 巧 (名古屋工業大学)	9:45		9:45	
10:00	6A-02 据え置き型機器とウェアラブル機器間の人体通信における大地グラウンドを含む電磁界解析 黒子美咲 (国土館大学)	10:00		10:00	
10:15	6A-03 人体を通信路とする頭部装用型ウェアラブル機器間の伝送メカニズム 村松大陸 (東京大学)	10:15		10:15	
10:30	6A-04 自動車における人体通信—腕部とハンドル間の通信の検討— 越地福朗 (国土館大学)	10:30		10:30	
10:45	休憩	10:45	「検査技術」 座長：大久保今朝秀 (日本フェンオール) 6B-01 依頼講演 3次元VLSIの故障検査法に関するサーベイ 高橋 寛 (愛媛大学大学院)	10:45	
11:00	「回路・実装設計技術」 座長：谷 貞宏 (ST-Lab) 6A-05 依頼講演 非対称な蛇行型等長配線差動伝送線路からの電磁放射特性 萱野良樹 (秋田大学)	11:00		11:00	
		11:15	6B-02 部品内蔵基板用静電容量型検査システムの開発 野口祐智 (東京電機大学)	11:15	
11:30	6A-06 差動信号用ペア配線に対するモード選択的導体損失抑制 山岸圭太郎 (三菱電機(株)情報技術総合研究所)	11:30	6B-03 SRAMのデータバス断線故障の電気検査法 橋爪正樹 (徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部)	11:30	
11:45	6A-07 OSRR (Open Sprit Ring Resonator) を用いた高速シリアル伝送の検討 奈良茂夫 (富士ゼロックス株式会社)	11:45	6B-04 ICのピン浮きの電気検査用組み込み型センサ 梅津翔一 (徳島大学大学院)	11:45	
12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	
13:00	「高速伝送実装」 座長：五百旗頭健吾 (岡山大学) 6A-08 高速伝送向けプリント配線板の特性についての一考察 永田 恵 (富士通アドバンステクノロジー株式会社)	13:00	「官能検査自動化技術」 座長：野中一洋 (産総研) 6B-05 依頼講演 濃淡むら抽出法の概観とフーリエ変換を用いたむら抽出法の提案 原 靖彦 (日本大学 工学部)	13:00	「環境調和型実装技術」 座長：林 秀臣 (芝浦工業大学) 6C-01 依頼講演 水素エネルギー社会に向けて—燃料電池とエネルギーキャリアー— 光島重徳 (横浜国立大学大学院工学研究院グリーン水素研究センター)
13:15	6A-09 バックプレーン配線の特性インピーダンスの最適化による伝送特性改善検討 小松聖児 (三菱電機株式会社)				
13:30	6A-10 高速伝送に向けたコンポジット材料のフィラー配向制御と誘電特性 菅 章紀 (名城大学)	13:30	6B-06 T形剥離試験によるFPC積層材の剥離強度試験の精度評価 宮城善一 (明治大学)	13:30	6C-02 高感度光酸発生剤の研究開発 柳澤智史 (株式会社ADEKA 情報化学品開発研究所)
13:45	6A-11 平衡形円板共振器法における測定の見直しに関する検討 中堤 純 (埼玉大学)	13:45	6B-07 偏光レーザーの散乱情報を用いた表面粗さ検査 劉 臨生 (産業技術総合研究所)	13:45	6C-03 修復機能を有する封止材向け樹脂硬化物の開発 布重 純 (株式会社日立製作所 日立研究所)
14:00	6A-12 金メッキ基板の特性 前田真一 (KEI Systems)	14:00	6B-08 色情報を用いた3D外観検査技術 坂井一文 (産業技術総合研究所)	14:00	休憩
14:15	6A-13 DDRメモリ搭載ボードのタイミング解析の高速化及び高精度化の検討 切中将樹 (富士通インターコネクテックテクノロジーズ株式会社)	14:15	休憩		

第2日目【3月6日】学生・初学者・初技術者向けチュートリアルセッション E会場

電子機器のものづくりを知ろう！—実装技術を基礎から分かり易く説明—
協賛：YUVEC, YJC（よこはま高度実装技術コンソーシアム）

	座長：高木 清 (YJC)
	概要編：
10:00～10:30	6E-01 ①電子機器における電子回路実装の重要性 羽深 等 (横浜国立大学)
	基礎編：
10:30～11:00	6E-02 ②回路図に表れないパワー回路混載プリント板実装設計の要点 井上博文 (NEDO)
	座長：宮代文夫 (YJC)
11:00～11:30	6E-03 ③ICT機器を支えるプリント配線板の技術動向 高木 清 (YJC)
11:30～12:00	6E-04 ④半導体デバイス・電子部品の微小化動向と実装技術 本多 進 (YJC)
	座長：本多 進 (YJC)
	応用編：
13:00～13:30	6E-05 ⑤身近なモバイル機器における実装技術の動向 八甫谷明彦 (東芝)
13:30～14:00	6E-06 ⑥シェールガスによるエネルギー革命とパワーデバイス実装動向 宮代文夫 (YJC)

第2日目【3月6日】ものづくりセッション D会場

	座長：上原利久 (京セラサーキットソリューションズ)
9:45	6D-01 高精度なメタルマスクの製造に適したステンレス鋼板 渋谷将行 (新日鐵住金株式会社)
10:05	6D-02 ガラス/ITOへのめっき技術 川島 敏 (メルテックス株式会社)
10:25	6D-03 ノンエッチング密着増強処理ノバボンドIT & セキュアHFz 本多俊雄 (アトテック ジャパン株式会社)
10:45	休憩
	座長：猪川幸司 (CMK)
11:00	6D-04 高性能ビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤「トッブルチナ IV, HV, VT」 塩野友之 (奥野製薬工業株式会社)
11:20	6D-05 高速バンプめっきプロセスの現状と課題 佐藤琢朗 (株式会社JCU 総合研究所)
11:40	6D-06 ENPIG用シアンフリー金めっき液 清原歓三 (日本高純度化学株式会社)
12:00	休憩
	座長：橋本 薫 (明星大学)
13:00	6D-07 2流体エッチングによる微細配線形成 片庭哲也 (株式会社ケミトロン)
13:20	6D-08 HDI基板向け異方性エッチング液 EXEシリーズ 東嶋豊恵 (メック株式会社)
13:40	6D-09 セイコーエプソンのWL-CSP技術 田中秀一 (セイコーエプソン株式会社)
14:00	6D-10 セラミックス質な白色反射膜を形成するペースト「ハイブリッドペースト」の開発 川本義樹 (古河ケミカルズ株式会社)

第2日目【3月6日】

【表彰式】

時間：14:20～14:55

場所：文京キャンパスC館3階 大教室

【特別講演】

日時：15:00～17:00

場所：文京キャンパスC館3階 大教室

座長：澁谷 昇（拓殖大学）

◆特別講演1

「ニューロニクスー脳と電子回路のインターフェイスー」

拓殖大学 副学長

川名明夫 氏

◆特別講演2

「ミニマルファブ構想と開発状況ー半導体製造技術の革新を目指してー」

産業技術総合研究所 研究参与

井上道弘 氏

【交流会】

日時：17:30頃より1時間半程度

場所：文京キャンパス食堂

講演セッション 第3日目 (3月7日) (1/2)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
9:45		9:45	「信頼性解析技術」 座長：田辺一彦 (NECインフロンティア) 7B-01 三次元貫通配線における劣化支配因子の解明 古屋亮輔 (東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻)	9:45	
10:00	「電子部品・実装技術」 座長：鈴木一高 (太陽誘電モバイルテクノロジー) 7A-01 アルミへの超音波はんだ接合の基礎検討 山崎浩次 (三菱電機株式会社)	10:00	7B-02 外部応力型ウィスカー防止はんだ材料の検討 鶴田加一 (千住金属工業株式会社)	10:00	「3次元実装技術システムインテグレーション実装技術」 座長：高野 希 (日立化成) 7C-01 依頼講演 溶融はんだを使用したマイクロポンプ形成法 鳥山和重 (日本アイ・ビー・エム株式会社)
10:15	7A-02 ナノ材料の機械的特性に与える空隙形状と酸化膜の影響に関する研究 齋藤良信 (横浜国立大学 工学府システム統合工学専攻 機械システム工学コース)	10:15	7B-03 放射光X線ラミノグラフィによるFBGAはんだ接合部の熱疲労き裂進展評価 花村拓哉 (富山県立大学)		
10:30	7A-03 ナノNi粒子による接合技術の研究 田中康紀 (早稲田大学情報生産システム研究科)	10:30	7B-04 パワー半導体ダイアタッチ接合部信頼性試験方法の検討 有井一伸 (エスベック株式会社)	10:30	7C-02 めっき中に生成されるビア/スルーホール内部のCu+濃度分布シミュレーション 林 太郎 (大阪府立大学)
10:45	休憩	10:45	休憩	10:45	7C-03 ナノパーティクルデポジション法で形成したAu微細円錐パンプ接続の接合電気特性評価 根本俊介 (独立行政法人産業技術総合研究所)
11:00	7A-04 銅と銀薄膜のプラズマ活性化接合 藤野真久 (東京大学工学系研究科精密工学専攻)	11:00	7B-05 依頼講演 金属接合部のエレクトロマイグレーション発生メカニズムの基礎と信頼性課題 山中公博 (中京大学)	11:00	休憩
11:15	7A-05 プラチナ触媒ギ酸処理を用いた銅/銅接合に及ぼす表面処理の影響 松岡直弥 (東京大学)			11:15	7C-04 広帯域データ転送のための高密度微細はんだ接合技術 末岡邦昭 (日本アイ・ビー・エム株式会社東京基礎研究所)
11:30	7A-06 超高真空中における銅単結晶を用いた常温での直接接合の研究 赤池正剛 (東京大学)	11:30	7B-06 各種はんだ合金のエレクトロマイグレーション挙動 入澤 淳 (株式会社弘輝)	11:30	7C-05 依頼講演 3D/2.5D実装向け微細配線技術の開発 谷 元昭 (株式会社富士通研究所)
11:45	7A-07 水素ラジカル処理したSnAg-Cuはんだのフラックスレス低温固相接合技術 川合紘夢 (東京大学)	11:45	7B-07 結晶粒界品質評価に基づく銅めっき薄膜配線の劣化挙動の可視化と高信頼化 浅井 修 (東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻)		
12:00	休憩	12:00	休憩	12:00	休憩
				12:45	「マイクロメカトロニクス実装技術」 座長：張 毅 (産業技術総合研究所) 7C-06 依頼講演 低温接合に基づく異種材料集積技術とフォトニクス応用 日暮栄治 (東京大学先端科学技術研究センター)
13:00	「電子部品・実装技術」 座長：土門孝彰 (TDK) 7A-08 依頼講演 次世代鉛フリーはんだ接合の動向 荘司郁夫 (群馬大学)	13:00	「サーマルマネジメント&パワーエレクトロニクス実装」 座長：柳浦 聡 (三菱電機) 7B-08 依頼講演 サーマルビアの効果的利用方法の検討 畠山友行 (富山県立大学)	13:15	7C-07 W薄膜を用いたウエハの室温接合技術におけるW膜厚と接合性能 魚本 幸 (東北大学学際科学フロンティア研究所)

講演セッション 第3日目 (3月7日) (2/2)

	【A会場】		【B会場】		【C会場】
13:30	7A-09 Alスパッタ中間層をもちいた表面活性化手法によるポリマー常温接合 松前貴司 (東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻)	13:30	7B-09 複数の発熱体が及ぼす相変化冷却の蒸発部性能の考察 蜂矢真弘 (日本電気株式会社)	13:30	7C-08 Ag薄膜を用いたウエハの室温接合と接合性能 今一恵 (東北大学学際科学フロンティア研究所)
13:45	7A-10 銀ナノ粒子レーザー焼結膜の銅ワイヤボンディング性能の評価 劉 夢清 (茨城大学大学院)	13:45	7B-10 パワー Si MOSFETにおけるホットスポット位置及び温度の電圧依存性 木伏理沙子 (富山県立大学)	13:45	7C-09 先鋭リムを用いた常温・高速封止接合技術の開発 多喜川 良 (九州大学)
14:00	7A-11 金ナノ粒子レーザー焼結によるフリップチップ実装用パッド形成 佐川貴久 (茨城大学大学院)	14:00	7B-11 レーザはんだ付けにおける基板への熱伝導の影響 畠山友行 (富山県立大学)	14:00	7C-10 めっき薄膜の内部応力を利用した強誘電体薄膜キャパシタの転写技術に関する研究 末重良宝 (東京大学工学系研究科精密工学専攻)
14:15	休憩	14:15	休憩	14:15	休憩
14:30	7A-12 銅ペースト焼成膜の焼成条件が導電性および熱応力に及ぼす影響 福田真治 (ファインセラミックス技術研究組合)	14:30	座長: 畠山友行 (富山県立大学) 7B-12 赤外線サーモグラフィの空間分解能評価方法に関する考察 平沢浩一 (KOA株式会社)	14:30	座長: 山口明啓 (兵庫県立大学) 7C-11 依頼講演 ナノ発熱機能素材による瞬間ハンダ接合技術とMEMS実装への応用 生津資大 (兵庫県立大学)
14:45	7A-13 スクリーンオフセット印刷装置の開発と高品質配線形成 野村健一 (独立行政法人 産業技術総合研究所)	14:45	7B-13 レーザーフラッシュ法による複合高分子材料の熱拡散率測定シミュレーション (定常法測定シミュレーション結果との比較) 上利泰幸 (大阪市立工業研究所)		
15:00	7A-14 Cu充填Al陽極酸化膜を用いた高密度3次元実装技術の開発 深澤 亮 (新光電気工業株式会社)	15:00	7B-14 金属微粉末を用いた焼結接合技術と製造装置の開発 倉持 譲 (東京大学大学院工学系研究科精密工学専攻須賀研究室)	15:00	7C-12 積層セラミック技術を組み合わせた電磁誘導式MEMSエアタービン発電機の開発 遠藤弘彬 (日本大学)
15:15	7A-15 鉛フリーはんだ/銅接合基板接合強度の測定 山内 啓 (群馬工業高等専門学校)	15:15	7B-15 プラズマ応用プロセスによる無加圧接合技術 小谷一哉 (株式会社ニッシン)	15:15	7C-13 ANN制御システムを搭載した昆虫型MEMSマイクロロボット 前角和明 (日本大学理工学部)
15:30		15:30	7B-16 高温動作SiC電力変換器に用いるAMC基板のCu配線変形及びクラックの生成 郎 豊群 (技術研究組合 次世代パワーエレクトロニクス研究開発機構)	15:30	7C-14 低温接合技術で作製したワイヤグリッド偏光子集積型偏光センサ 池田 颯 (東京大学)
15:45		15:45		15:45	7C-15 カーボンナノチューブを応用した二次元アレイ型ひずみセンサ 川上浩司 (東北大学大学院工学研究科ナノメカニクス専攻)
16:00		16:00		16:00	7C-16 太陽光発電テキスタイルの開発 増田敦士 (福井県工業技術センター)

第3日目【3月7日】ものづくりセッション D会場

	座長：中尾 知 (フジクラ)
9:45	7D-01 低温硬化・フレキシブル導電性接着剤‘SX-ECAシリーズ’の特性 岡部祐輔 (セメダイン株式会社)
10:05	7D-02 低温・短時間硬化型接着剤 北村和大 (富士通クオリティ・ラボ株式会社)
10:25	7D-03 パワーデバイス用の高熱伝導薄膜フィルムの開発 高杉寛史 (ナミックス株式会社)
10:45	休憩
	座長：和嶋元世 (c-net)
11:00	7D-04 新規高速・高周波対応ハロゲンフリー低伝送損失多層材料 永井裕希 (日立化成株式会社)
11:20	7D-05 均一な銅厚分布を有する極薄銅ポリイミド両面2層めっき基板 須田貴広 (住友金属鉱山株式会社)
11:40	7D-06 低膨張基板対応低温ガラス「ProGlass LEシリーズ」 戸田 勲 (奥野製薬工業株式会社)
12:00	休憩
	座長：本多 進 (YJC)
13:00	7D-07 パワーデバイス用窒化アルミニウム基板 金近幸博 (株式会社トクヤマ)
13:20	7D-08 ポリイミド金属ベース基板材料「ユピセル® H」の開発 笠原純也 (宇部エクスモ株式会社 研究所)
13:40	7D-09 高放熱プリント配線板から高耐熱プリント配線板へ 一色和彦 (株式会社ちの技研)
14:00	7D-10 薄膜キャパシタ応用インターポーザの開発 服部篤典 (株式会社 野田スクリーン)
14:20	7D-11 モジュール型汎用自動組立装置 Smart FAB による 3D-MID 実装のご紹介 岩城範明 (富士機械製造)